

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司 关于拟设立沈阳分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、设立分公司概述

(一) 基本情况

根据公司经营发展的需要，进一步开拓公司业务，促进公司长期可持续发展，公司拟在辽宁省沈阳市设立北京天科合达半导体股份有限公司沈阳分公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准）。

(四) 审议和表决情况

北京天科合达半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟设立沈阳分公司的议案》，同意公司在辽宁省沈阳市北京天科合达半导体股份有限公司沈阳分公司。根据《公司章程》相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需公司股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

名称：北京天科合达半导体股份有限公司沈阳分公司

注册地址：辽宁省沈阳市于洪区（暂定以工商行政管理部门核准登记为准，）

企业类型：股份有限公司分公司（非上市）

主营业务：半导体晶体生长工艺以及装备技术研发、生产、制造、销售以及维修服务。

三、设立分公司的目的，存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，巩固并提高公司综合竞争力，为股东创造更多的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立分公司，符合公司的战略规划及经营发展需要，有利于公司开拓业务，完善公司管理体系，是适合公司发展及市场变化的需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

一、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司完善业务布局，提高公司的行业地位和综合竞争力，提高公司盈利能力，预期将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

二、备查文件目录

(一)《北京天科合达半导体股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日